

NASclean® Micro&Fine

超精密ガスフィルター

Technology で 次代に躍進



製品群

- ・小流量～大流量 (1SLM～20,000Nm³/h)
 - ・集積フィルター (W シール、C シール、他)
 - ・ガスケットフィルター (1/4"、3/8")
 - ※材質：SUS、ハステロイ、純 Ni、PTFE
 - ・高速ベントフィルター (半導体、液晶向け)

お問い合わせ : semicon@n-seisen.co.jp



 大同特殊鋼グループ
日本精線株式会社 本社〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-1-1 TEL.06-6222-5439FAX.06-6222-1250
<http://www.n-seisen.co.jp>

Assembly & Packaging - パッケージング工程に関するスタンダード

G88-0211	Specification for Tape Frame for 450 mm Wafer / 450mmウエハー用テープフレームの仕様
G92-1113	Specification for Tape Frame Cassette for 450mm Wafer / 450mmウエハーのためのテープフレームカセットの仕様
G95-0613	Mechanical Interface Specification for 450 mm Load Port for Tape Frame Cassettes in the Backend Process / 後工程のテープフレームカセット用450mmロードポートのメカニカルインターフェースの仕様

Physical Interfaces & Carriers - 半導体製造分野に関するスタンダード

E83-0413	Specification for PGV Mechanical Docking Flange / PGVメカニカルドッキングフランジの仕様
E154-0713	Mechanical Interface Specification for 450 mm Load Port / 450 mm ロードポートのためのメカニカルインターフェースの仕様
E156-0710	Mechanical Specification for 450 mm AMHS Stocker to Transport Interface / 移送のための450 mm AMHS（自動搬送システム）用ストッカーのインターフェースのメカニカル仕様
E158-0912	Mechanical Specification for Fab Wafer Carrier Used to Transport and Store 450 mm Wafers (450 FOUP) and Kinematic Coupling / 450mmウエハー搬送および保管用のウエハーキャリア (450FOUP) とキネマティックカップリングのメカニカル仕様
E159-0912	Mechanical Specification for Multi Application Carrier (MAC) Used to Transport and Ship 450 mm Wafers / 450mmウエハーの搬送および、搬送のための多目的キャリア (MAC: Multi Application Carrier) のメカニカル仕様
E162-0912	Mechanical Interface Specification for 450 mm Front-Opening Shipping Box Load Port / 450mmフロントオープニング・シッピングボックス・ロードポートのためのメカニカルインターフェースの仕様
E166-0513	Specification for 450 mm Cluster Module Interface: Mechanical Interface and Transport Standard / 450mmクラスター・モジュールインターフェースのための仕様：メカニカルインターフェースおよび搬送スタンダード
AUX023-1113	Overview Guide to SEMI Standard for 450 mm Wafers / 450mmウエハーに関するSEMIスタンダード全体ガイド

Silicon Wafer - シリコンウエハーに関するスタンダード

M1-0114	Specification for Polished Single Crystal Silicon Wafers / 鏡面単結晶シリコンウエハーの仕様
M49-0613	Guide for Specifying Geometry Measurement Systems for Silicon Wafers for the 130 nm to 16 nm Technology Generations / 130nmから16nmへの技術世代のシリコンウエハー用ジオメトリ測定システム規定のためのガイド
M52-0214	Guide for Specifying Scanning Surface Inspection Systems for Silicon Wafers for the 130nm to 11nm Technology Generations / 130nmから11nm技術世代シリコンウエハー用走査型表面検査装置仕様のためのガイド
M62-0413	Specifications for Silicon Epitaxial Wafers / シリコンエピタキシャルウエハーの仕様
M73-1013	Test Methods for Extracting Relevant Characteristics from Measured Wafer Edge Profiles / 測定したウエハーのエッジプロファイルから直接的関連性ある特性を抽出する試験方法
M74-1108 (Reapproved 0413)	Specification for 450mm Diameter Mechanical Handling Polished Wafers / 450mmメカニカルハンドリング鏡面ウエハーの仕様
M76-0710	Specification for Developmental 450mm Diameter Polished Single Crystal Silicon Wafers / 開発用直径450mmシリコン単結晶鏡面ウエハーの仕様
M80-0812	Mechanical Specification for Front-Opening Shipping Box Used to Transport and Ship 450mm Wafers / 450mmウエハーの搬送および出荷用フロントオープニング・シッピングボックスの機械仕様

2014年1月にアップデートされた450mmエハ-1関連のSEMIスタンダード（SEMI発表資料より作成）



技術力と提案力でエレクトロニクス商社No.1をめざします

東京エレクトロンデバイス

私たち東京エレクトロンデバイスは、世界中から最先端の半導体やＩＴ機器を調達し、的確なソリューションを提供する「提案力」と、お客様ごとに最適かつ高度な設計・開発・サポートを行う「技術力」で、お客様にとってかけがえのないビジネスパートナーをめざしています。

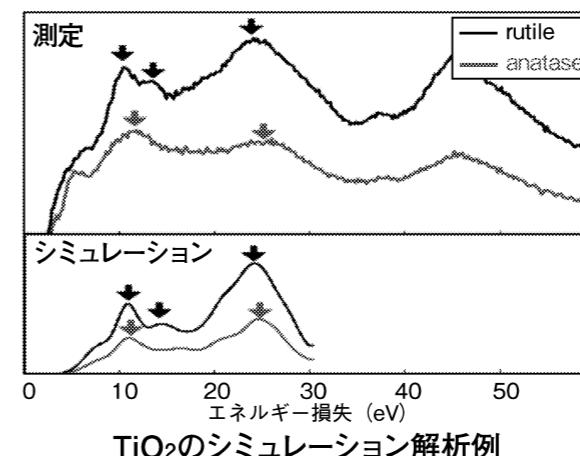
取り扱い商品 電子部品事業 ●半導体製品/ソフトウェア/電子部品ほか ●インテリアム(設計受託/量産受託/自社ブランド商
コンピュータ・ネットワーク事業 ●ネットワーク/ストレージ/ミドルウェア



東京エレクトロン デバイス株式会社

〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町
<http://www.teldevice.co.jp>

半導体デバイスと製造装置



TiO₂のシミュレーション解析例

電子エネルギー損失分光法 (EELS) の外殻電子励起スペクトルと損失関数 (材料科学技術振興財団提供)

進化する解析技術

